29a-A7-3

## エピタキシャル Sm-Ni 合金薄膜の形成と構造解析

## Preparation and Structural Characterization of Sm-Ni Alloy Epitaxial Thin Films

中央大理工<sup>1</sup>, 東京藝大<sup>2</sup> <sup>0</sup>堀田 裕介<sup>1</sup>, 柳川 貴人<sup>1</sup>, 大竹 充<sup>1</sup>, 桐野 文良<sup>2</sup>, 二本 正昭<sup>1</sup>

Chuo Univ.<sup>1</sup>, Tokyo Univ. Arts<sup>2</sup>

<sup>o</sup>Yusuke Hotta<sup>1</sup>, Takato Yanagawa<sup>1</sup>, Mitsuru Ohtake<sup>1</sup>, Fumiyoshi Kirino<sup>2</sup>, Masaaki Futamoto<sup>1</sup>

## E-mail: hotta@futamoto.elect.chuo-u.ac.jp

希土類金属(R) と 3d 強磁性遷移金属(T) からなる  $RT_5$ 型規則合金は高い  $K_u$ を示すものが多く、そのため、その薄膜は記録媒体などへの応用に向けて研究されている。合金材料の構造と磁

気特性の関係を調べるためには、結晶配向が制 御されたエピタキシャル膜を用いるのが有効 である. SmCo<sub>5</sub><sup>1)</sup>, PrCo<sub>5</sub><sup>2)</sup>, NdCo<sub>5</sub><sup>3)</sup>などの RCo<sub>5</sub> 系規則合金のエピタキシャル膜についての報 告は多く存在するが、Tとして Co 以外の 3d 強 磁性遷移金属を用いた RT5 膜の形成例は少ない. Ni や Fe を用いた RT5 膜を形成できれば, 磁気 特性の制御範囲を拡大することができる.本研 究では、エピタキシャル SmNis 規則合金膜形成 を目的として単結晶基板上に Sm-Ni 膜の形成を 試み,その構造解析を行った. 試料作製には超 高真空分子線エピタキシー装置を用いた. MgO(111)基板上にヘテロエピタキシャル成長 させた Cu(111)下地層上に, RT から 500 ℃ の間 の一定基板温度で、20 nm 厚の Sm<sub>17</sub>Ni<sub>83</sub> (at. %) 膜を形成した.構造評価には RHEED および XRD を、磁化曲線測定には VSM を用いた.

Fig. 1(a)-(c)に基板温度 500 °C において Sm-Ni 膜形成中に観察した RHEED パターンを示す. 形成初期段階から製膜後まで Fig. 1(d)に示す RT<sub>5</sub>(0001)表面に対応する規則的な回折パター ンが観察され、規則合金膜が形成されているこ とが確認された.この SmNi<sub>5</sub> 規則合金膜は, RHEED スポット配置から膜面垂直方向で互い に 30°回転した方位関係を持つ 2 つのバリアン ト (Fig. 2, Type A, Type B) から構成されている ことが分かった.極点図形 XRD 測定により評 価したタイプ A と B のバリアントの体積比は A:B = 75:25 であった. Fig. 3 に XRD スペクトル を示す. 面外スペクトルでは, SmNi<sub>5</sub>(0002)基本 反射に加え, SmNi<sub>5</sub>(0001)超格子反射も観察され ており、RHEED 解析結果と同様に、規則相が 形成されていることを示している.一方,面内 スペクトルでは,バリアントに対応する SmNi<sub>5</sub>(2200)および(1120)反射が認められる. XRD 反射から算出した SmNi<sub>5</sub> 膜の格子定数は (*a*, *c*) = (0.495 nm, 0.399 nm)であった. 当日は, 基板温度が膜構造に及ぼす影響についても報 告する.

E. E. Fullerton *et al.*, *Appl. Phys. Lett.* **71** (1997) 1579.
A. K. Patra *et al.*, *Phys. Rev. B* **75** (2007) 184417.
M. Seifert *et al.*, *J. Appl. Phys.* **106** (2009) 073915.



**Fig. 1** (a)–(c) RHEED patterns observed during Sm-Ni deposition on Cu(111) underlayer at 500 °C. The Sm-Ni film thicknesses are (a) 2, (b) 10, and (c) 20 nm. (d) Schematic diagram of RHEED pattern simulated for  $RT_5(0001)$  surface. Open and filled circles respectively correspond to the types A and B explained in Fig. 2.



Fig. 2 Epitaxial orientation relationships between  $SmNi_5(0001)$  film and Cu(111) underlayer: (a)  $SmNi_5[11\overline{2}0] \parallel Cu[1\overline{1}0]$  and (b)  $SmNi_5[1\overline{1}00] \parallel Cu[1\overline{1}0]$ .



Fig. 3 (a) Out-of-plane and (b) in-plane XRD spectra of an Sm-Ni film deposited on Cu(111) underlayer at 500 °C.